

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 电话会议
参与单位名称	巨曦基金、汇添富基金、华西证券、银河证券、德蓝资产、君榕资产
时间	2025 年 11 月 12 日-11 月 13 日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 合规总监：李璠媛 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：今年收入增速较快，是哪些客户和产品贡献？ 答：2025 年前三季度收入增长 40.70%，主要得益于半导体行业景气度提升和公司产品技术突破两方面的驱动。一方面半导体行业整体景气度提升，下游客户稼动率提升，从而带动公司核心产品需求增加。另一方面公司产品不断突破，公司在先进封装、晶圆领域以及光刻胶及配套试剂方面的收入提高，另外马来西亚子公司 INOFINE 贡献收入占比约 7%。总的来说，公司 2025 年收入增长的核心驱动力为头部晶圆厂、先进封装厂及海外业务，产品包括先进封装材料如先进封装光刻胶及配套试剂、

	晶圆制造材料如 28nm 大马士革镀铜添加剂及配套试剂。 问题二：公司 KrF 光刻胶的技术特性及研发进展如何？ 答：公司 KrF 光刻胶在高厚膜下，通过优化树脂和 PAG，提升分辨率，相应提高光刻胶深宽比，一方面实现更强的刻蚀抵抗力，满足更长时间、更具选择性的刻蚀工艺，以确保将图形清晰地转移到下层材料上；另一方面实现更稳定的离子注入掩膜，并且在离子注入工艺中，防止离子穿透到不该进入的区域，从而精确地定义掺杂区域。目前公司 KrF 光刻胶 AR（深宽比）>13，主要应用于 CIS isolation 等高深宽比结构，包括存储芯片的相应结构，下一步将在头部晶圆厂上线测试。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 13 日